

# 东莞回收QX泉芯IC芯片

产品名称	东莞回收QX泉芯IC芯片
公司名称	深圳市东城电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	全国各地都可回收
联系电话	158****7035 158****7035

## 产品详情

双列直插式封装。插装型封装之一，引脚从封装两侧引出，封装材料有塑料和陶瓷两种。欧洲半导体厂家多用DIL。DIP 是普及的插装型封装，应用范围包括标准逻辑IC，存储器LSI，微机电路等。引脚中心距2.54mm，引脚数从6到64。封装宽度通常为15.2mm。有的把宽度为7.52mm和10.16mm的封装分别称为SK-DIP（skinny dual in-line package）和SL-DIP（slim dual in-line package）窄体型DIP。但多数情况下并不加区分，只简单地统称为DIP。另外，用低熔点玻璃密封的陶瓷DIP也称为Cerdip（4.2）。

### 4.1 DIC（dual in-line ceramic package）

陶瓷封装的DIP（含玻璃密封）的别称。

MCP6232T-E/SN

MCP617T-I/SN

MCP607T-I/SN

MCP6072T-E/SN

MCP606T-I/OT

RT9193-33GB

RT9179PB

RT9179GB

RT9166-33GVL

RT9161A-33GV

RT9161-50GV

RT9013-33GB

RT9013-18GB

AO4440

AOD200

AO4601

AO4613

AO4627

AO4629

AO4922

AO4924

FDS5692Z

FDS3512

FDS7766S

FDS7766

FDS6994S

FDS8882

FDS6892AZ

FDS6680S

Si2343DS-T1-E3

Si2333CDS-T1-GE3

Si2319CDS-T1-GE3

Si2312CDS-T1-GE3

SI2307CDS-T1-GE3

Si2305CDS-T1-GE3

Si2303CDS-T1-GE3

Si2303CDS-T1-E3

HMC481MP86E

MP2130DG-C423-LF-Z

MSA-0486-TR1G

NTMFS4119NT1G

NJM4580CG-TE2

NTMFS4C09NAT1G

NTV1215MC

IRFH7936TRPBF

TLV61220DBVR

TLV803SDBZR

TPS3808G01DBVR

TPS563201DDCR

TLV70233DBVR

MP24894GJ-Z

OPA333AIDCKR

INA199A3DCKR